산업통상자원부	**보 도 자 료**	http://www.motie.go.kr

2019년 5월 24일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 5.23일(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2019. 5. 22(수)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박종원 과장(044-203-4270)	담 당 자	권영희 서기관(044-203-4271) 주미나 사무관(044-203-4273)

산업부 장관, 시스템반도체 팹리스 업체 현장방문

- "시스템반도체 비전과 전략" 팹리스 부문 후속조치 본격화 -
- 시스템반도체 업계 현장과 소통행보 시작 -

□ **성윤모 산업통상자원부 장관**은 5월 23일(목), 경기도 판교 소재의 시스템반도체 설계기업(팹리스)인 **넥스트칩을 방문**하였다.

< 현장방문 개요 >
ㅇ 일시/장소 : 5.23(목) 14:30~15:30 / 넥스트칩
ㅇ 참 석 자 : (산업부) 장관, 소재부품산업정책관, 반도체디스플레이 과장 등
(넥스트칩) 김경수 대표 등 임직원
(유관기관) 전자부품연구원, 반도체협회 등
ㅇ 내 용 : 팹리스 지원방안 등 시스템반도체 전략 후속조치, 업계 애로사항 청취

○ 금번 방문은 지난 4월 30일 발표한 **"시스템반도체 비전과 전략" 후속조치**로서, 팹리스 지원대책 추진상황을 업계에 전달하고,

○ 시스템반도체 산업의 핵심주체인 팹리스 기업현장을 둘러보고 업계와 적극 소통하고자 마련되었다.

□ 이날 방문한 **넥스트칩**은 1997년에 설립된 이래 카메라 영상신호처리(ISP: Image Signal Processing) 반도체 설계기술을 개발해왔으며,

○ 보안카메라용 영상처리 반도체에서 최근 **차량용 고화질 영상처리 반도체**를 개발하여, 중국 현대·기아차, 일본 자동차 1차 밴더인 클라리온에 납품하는 등 차량용 반도체 시장에서 성과를 거두고 있다.

* 차량용반도체 시장전망(억달러, IHS, '18) : ('18) 256 → ('20e) 282 → ('22e) 330

□ 이날 성 장관은 김경수 대표 등 경영진과 간담회를 진행하면서, **「시스템반도체의 비전과 전략」의 팹리스 부문 후속조치들을 "선택과 집중을 통해" 기업이 체감할 수 있는 방향으로 추진**하겠다고 밝혔다.

< 팹리스 대책 기본방향 >

○ 시스템반도체 개발과 양산에 장기간, 고비용이 소요되어 매출을 올리기까지 **중소 팹리스가 감당할 리스크**가 크기 때문에,

- 정부 지원책도 우수한 **기술력을 갖춘 팹리스 기업들을 대상으로 기술개발·수요연계·시제품 제작지원 등의 일괄적 지원을 받도록 추진하겠다**는 점을 강조하였다.

< 수요연계형 R&D 추진 >

○ **차세대 지능형 반도체 기술개발 사업**(산업부·과기정통부, '20~'29)에 **총 1조 96억원을 확보(산업부: 5,216억원, '20~'26)**하였으며,

- 이중 자동차, 바이오·헬스, 스마트 가전 등 5대 유망분야의 시스템 반도체 설계 기술개발에 2,705억원(국고 2,305, 민자 400)을 팹리스 업계에 투자한다.

【 시스템반도체 설계분야 기술개발 과제 기획방향 】

분 야	과제 예시
자동차 (913억원)	▸ 레벨3 이상 차량용 복합 센서 신호처리 칩셋 및 플랫폼 ▸ 실시간 충돌회피 및 대응 Intelligence가 탑재된 SoC
바이오·헬스 (714억원)	▸ Body on Chip 센싱 SoC (종양, 신장 등) ▸ 초정밀 일회용 분자진단 반도체 센서 SoC
스마트가전 (456억원)	▸ 다중센서 융합을 위한 센서 인터페이스 및 Synthetic SoC ▸ 신호보정 기술기반 실내 공기질 측정 센서 SoC 및 모듈
에너지 (313억원)	▸ 고효율 초저전력 엣지 SoC 소자 및 회로 기술 ▸ 고전압 全고체(all-solid-state) 배터리 분산형 배터리 제어 SoC
기계·로봇 (309억원)	▸ 360도 전방위 상황인지를 위한 APD 기반 Hybrid Lidar SoC ▸ 3차원 작업 공간 인지 다채널 고속 신호처리 비접촉센서 SoC

○ 지난달 확대 출범한 자동차, 바이오·의료, 에너지 등 5대 분야의 수요-반도체기업 **"얼라이언스 2.0*"이 가동중**이며,

* 자동차, 바이오, 가전, 에너지, 로봇 등 5대 분야 수요기업-팹리스 등 25개 기관간 MOU 체결(4.30)

- **수요기업과 국내 팹리스간 연계 채널을 운영**함과 동시에 **수요기업이 원하는 반도체 기술을 R&D 과제화(연간 최대 300억원 지원)**하여 국내 팹리스를 통해 **제품개발**이 이뤄지도록 할 계획이다.

- 우선 금년에는 **5개 과제에 32억원**이 배정되었는데 **넥스트칩이 '19년 얼라이언스 과제 수행기관** 중 하나로 선정되는 등 얼라이언스를 통한 **기술개발이 본격화**되고 있다.

* 인케빈 카메라용 지능형 신호처리 반도체 기술개발('19년 7억원, '19~'21년 14.5억원)

< 팹리스 전용 펀드 등 스케일업 지원 >

○ 민간 주도의 팹리스 전용펀드(1,000억원 규모)는 모펀드 운용사* 선정 및 MOU 체결(8월) 등을 통해 **연내 출시할 계획**이며,

* 모펀드 운용사: 모펀드 설정부터 하위펀드 결성·관리까지 펀드 관련 제반업무 수행

- **기술력을 갖춘 팹리스 기업들이 집중 지원**받을 수 있도록 **국책 R&D과제 수행기업, 수출 및 공공부문 프로젝트 참여 기업, 얼라이언스 2.0 참여기업 등**을 우선 지원할 수 있도록 할 것이다.

○ 또한, **성장지원펀드 등 스케일업 펀드, 4차 산업혁명펀드 등을 팹리스 업계**가 적극 활용할 수 있도록 펀드 활용에 대한 기업 IR(6.13, 반도체협회)을 개최한다.

< 팹리스 인력양성 >

○ 금년에 기업과 정부가 1:1로 매칭하는 **기업 수요맞춤형 인력양성 사업(40억원, 삼성전자·SK하이닉스·SK씰트론 참여)을 시행하며,**

- 신규예타 사업(1,400억원 규모)을 기획하여 내년부터 대기업뿐만 아니라 관심있는 **팹리스 업계도 참여하도록** 하여,

- 팹리스 업계가 필요한 기술개발 사업에 정부가 50%의 자금을 매칭하고 대학원 석·박사급 인력 참여를 통한 **설계 전문인력 양성도 도모할** 계획이다.

□ **김경수 넥스트칩 대표**는 반도체를 개발해서 실제 매출을 올리기까지 장기간이 소요되고 비용부담이 크지만, 고급 기술개발을 지향하지 않고는 해외 경쟁업체에 따라잡히기 때문에 기업은 리스크를 안고 갈 수밖에 없다는 점을 설명하면서,

○ **금번 대책이 기술을 보유한 팹리스 업계 전반의 경쟁력을 업그레이드할 것으로 기대**하며, 팹리스 전용펀드 등 자금도 긴 안목으로 팹리스 업계에 투자되었으면 한다고 언급하였다.

□ 성 장관은 마무리 발언을 통해 "금번 시스템반도체 비전과 전략을 통해 **2030년 팹리스시장 점유율 10% 달성이라는 야심찬 목표를 설정**했지만, 결국은 **한국판 퀄컴이나 NXP와 같은 우수한 팹리스 기업이 배출되는 것이 진정한 시스템반도체 산업의 발전**이기 때문에 정부도 팹리스 업계에 지속적이고 장기적 투자가 이뤄질 수 있도록 계속 관심을 기울이겠다."고 강조하였다.

※ 현장사진은 별도 배포 예정

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 권영희 서기관(☎044-203-4271), 주미나 사무관(☎ 044-203-4273)에게 연락주시기 바랍니다.

참 고 **현장방문 개요**

□ 목 적

○ 4.30일 발표한 「시스템반도체 비전과 전략」의 팹리스 지원대책을 속도감있게 추진하고, 업계 애로사항 청취 등 적극적 소통 전개

□ 일시 및 장소

○ **(일시)** ’19.5.23(목) 14:30~15:30

○ **(장소)** 넥스트칩 본사(경기 성남시 분당구 판교역로 230 삼환하이펙스 B동 10층)

○ **(제품)** 차량용 고화질 영상 신호처리 반도체

< 넥스트칩 >

※ **’97년 설립된 이래 카메라 기반 영상 신호처리(ISP: Image Signal Processing) 반도체** 개발 → 보안카메라용에서 **자동차용 고급영상처리 반도체 양산**에 성공

* 중국 현대·기아차, 일본 자동차 1차 밴더인 클라리온 등에 납품

□ 참석자

○ **(산업부·유관기관)** 장관, 소재부품산업정책관, 반도체디스플레이과장, 산업기술평가관리원, 전자부품연구원, 반도체협회 등

○ **(넥스트칩)** 경영진(김경수 대표 등) 등 임직원

□ 세부일정 ※ 인사말씀까지 공개

시간	주요 내용	비고
14:30~15:10 (40’)	• 인사말씀	회의실
	• 회사 소개	
	• 차세대 지능형 반도체 기술개발 지원	
	• 얼라이언스 2.0 운영 계획	
	• 간담회	
15:10~15:30 (20’)	• 주요 제품 소개 및 직원 격려	사무실